公司代码:688432　　公司简称:有研硅

有研半导体硅材料股份公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2025年3月27日召开的第二届董事会第八会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币0.60元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。本次利润分配方案尚需经股东会审议批准。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所创板	有研硅	688432	不适用	

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨凌	孙媛
联系地址	北京市西城区新街口外大街2号D座17层	北京市西城区新街口外大街2号D座17层
电话	010-82087088	010-82087088
传真	010-62355381	010-62355381
电子信箱	gritekipo@gritek.com	gritekipo@gritek.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售,主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶、半导体洁净管阀门等,半导体洁净管阀门等,主要用于集成电路、分立器件、功率器件、传感器、光学器件、刻蚀设备用硅部件等的制造,并广泛应用于汽车电子、工业电子、航空航天等领域。

2、主要产品

公司主要产品包括半导体硅抛光片、刻蚀设备用硅材料、半导体区熔硅单晶、半导体洁净管阀件等。

具体如下:

(1)半导体硅抛光片

半导体硅抛光片是生产射频前端芯片、传感器、模拟芯片、分立器件、功率器件等半导体产品的关键基础材料。公司主要半导体硅抛光片产品尺寸为6英寸以及6英寸。

(2)刻蚀设备用硅材料

刻蚀设备用硅材料主要应用于加工制成刻蚀用硅部件,公司生产的刻蚀设备用硅材料尺寸范围涵盖11至21英寸,其中90%以上产品为14英寸以上大尺寸产品,主要产品形态包括单晶硅棒、硅筒、硅切割电极片和硅切割环片等。

(3)半导体区熔硅单晶

主要包括区熔硅单晶棒和区熔硅片。区熔硅单晶具有高纯度、高电阻率、低氧含量等优点,区熔硅片主要应用于制造高压整流器和晶体管等大功率器件,探测器、传感器等敏感器件,微波单片集成电路(MMIC)、微电子机械系统(MEMS)等高端微电子器件的核心材料。

(4)半导体洁净管阀件

主要包括减压阀、波纹管阀、隔膜阀、超高纯阀门等,应用于集成电路、光伏、新能源、光纤通信、实验室、石油化工等。

1.盈利模式

公司主要从事半导体硅材料的研发、生产和销售,通过向下游芯片制造企业销售半导体硅片,向下游刻蚀设备部件制造企业销售刻蚀设备用硅单晶等产品实现收入和利润。

2.采购模式

为保证公司原辅材料的高质量和稳定性,公司建立了严格的供应商管理制度,对供应商实行严格认证。根据供应商的资质条件、产品质量、技术实力、供货能力、服务水平、财务状况等情况对供应商进行综合评价,将符合条件的供应商纳入合格供应商范围进行采购。对合格供应商定期审核评估,并确保主要原辅材料有两家以上合格供应商具备供应能力。

3.生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式,主要产品根据客户的差异化需求进行工艺设计及生产制造。市场营销部根据市场需求制定销售计划,生产管理部根据销售部提供的市场需求预测编制年度生产计划,并结合客户订单情况编制月度生产计划;技术研发部根据生产管理部提供的生产计划审核产品规范;制造部根据生产计划和技术要求组织生产,完成生产任务。公司对产品进行严格的质量管控,按要求进行产品测试及质量检验,确保公司产品质量。

公司在技术水平和生产管理方面有着突深积淀,利用SAP管理系统、MES生产管理系统和WMS仓储管理系统,在产品开发、原材料采购、产品生产、出入库检验、销售服务等过程中严格实施标准化管理和控制,实施精益生产,使产品质量的稳定性及一致性达到国内领先水平。

4.销售模式

报告期内,公司销售以直销为主,同时存在少量经销以及代理。直销模式下,公司直接与下游客户签订业务合同;经销模式下,公司把产品出售给贸易商,由贸易商付售给终端用客户;代理模式下,公司把产品直接销售给客户,与最终用户签订销售协议,并向代理商支付佣金。公司产品销售价格以市场价格为基础,根据供需情况、客户的定制化需求,结合公司产能、交易条款等进行适当调整。

2.3所处行业情况

(1).行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业的发展阶段

受部分相应终端应用领域的终端需求疲软及去库存影响,2024年全球硅片出货量下降27%至12,266百万平方英寸;同期硅片销售额下滑6.5%至115亿美元。但全球硅片需求已于2024年下半年开始从2023年的行业下行周期中复苏,整体向好的趋势已经显现,伴随新能源、大数据等领域的发展,将会带动半导体硅片需求的增加。

(2)基本特点

1.行业周期性强

受到宏观经济及上下游供需状况的影响,终端应用领域如消费电子、汽车电子、工业电子等行业与宏观经济形势紧密相关,半导体产品基础制造企业随着整体 经济状况和上下游行业的变化呈现出一定的周期性。

2.产业集中度高

全球半导体硅片集中在日本信越、SUMCO、台湾环球晶圆等五家国际大厂,其产业规模、技术水平、盈利能力等方面处于领先,国内正加速追赶,在技术研发、产品质量、资金投入等方面与国际领先企业展开竞争。

3.人才需求密集

半导体硅材料制造处晶高度技术密集型行业,研发生产过程较为复杂,涉及微电子学、半导体物理学、材料学等诸多学科,在晶体生长、硅片研磨加工以及应用领域等方面对硅片的电学参数等性能提出了越来越高的要求,需要具备综合专业知识和丰富生产经验的复合型人才。

4.固定资产投资大

半导体硅材料行业属于资金密集型行业。半导体硅抛光片和刻蚀设备用硅材料制造工艺复杂,生产所需先进设备价格高,硅片企业要形成规模化生产,所需投资规模巨大,并且随着技术的进步,客户的需求不同,还需要对生产设备不断进行改造和升级,需要大量的运转资金。

(3)主要技术门槛

半导体硅片制造核心工艺包括单晶生长和硅片精密加工。硅单晶生长核心技术主要包括热场设计、掺杂技术、磁场技术、氧浓度控制等,硅片精密加工技术主要包括硅片厚度变化、硅片翘曲、硅片弯曲、表面局部平整度、硅片表面粗糙度、硅片几何参数及硅片表面的超洁净控制;刻蚀设备用硅材料核心指标包括缺陷密度、杂质含量、电阻率范围及分布均匀性等。工艺技术水平决定了产品良品率和参数一致性。上述指标越着集成电路制程的不断进步愈发严格,对市场新进入者形成了较高的技术壁垒。

(2).公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内半导体材料龙头企业,是国家高新技术企业,拥有国家企业技术中心、国家技术创新示范企业等称发及创新平台,是集成电路关键材料国家工程研究中心依托单位。公司是中国半体行业协会常务理事单位、中国电子材料行业协会副理事长单位、中关村集成电路材料产业技术创新联盟副理事长单位、北京半体行业协会常务理事单位、中国有色金属工业协会硅业分会副会长单位。

公司坚持推动募投项目的实施,产能规模不断扩大;坚持实施创新驱动战略,不断加大研发投入,实现产品技术迭代,保持行业领先;通过参股方式布局的12英寸硅片项目实现通线量产,产品水平和产品结构进一步优化提升,行业地位显著提升。

(3).投资内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

集成电路芯片技术发展呈现出两个主要特点:一是继续延续摩尔定律,以集成电路制程微细化为特征,技术上满足更先进制程,提高集成度和功能,同时提升性能及功耗。二是随着人工智能升级的需求增加,为提升高性能单芯片的集成度与复杂性,优化性能与功耗,集成电路行业正在从系统级芯片向系统级封装的转型。

集成电路产业发展对半导体硅片提出更高的技术要求,包括单晶晶体缺陷、晶体中氧碳及掺杂物质的均匀分布、平整度等加工精密度参数,体金属浓度和表面金属浓度等纯度指标。同时为了突破硅材料性能的局限性,与其他材料的整合成为重要路径,比如结合键合工艺开发的绝缘体上硅(SOI)、通过应变引入实现能带调制的应变硅、硅基氮化镓等都已实用化,未来硅与锗化铟、石墨烯、硫化钼等材料的结合可能是后摩尔时代硅材料的重要发展方向。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	536,776.84	504,305.63	6.44	496,425.76
归属于上市公司股东的净资产	434,158.70	414,799.84	4.67	398,293.17
营业收入	99,594.59	96,040.33	3.70	117,531.93
归属于上市公司股东的净利润	23,290.38	25,418.10	-8.37	35,132.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,302.23	16,500.37	-1.20	31,300.47
经营活动产生的现金流量净额	22,936.80	26,664.28	-13.98	43,035.26
加权平均净资产收益率(%)	5.51	6.23	减少0.72个百分点	14.71
基本每股收益(元/股)	0.1871	0.2037	-8.15	0.3229
稀释每股收益(元/股)	0.1871	0.2037	-8.15	0.3229
研发投入占营业收入的比例(%)	7.86	8.56	减少0.70个百分点	7.21

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:万元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	23,468.25	27,247.83	26,594.16	22,284.35
归属于上市公司股东的净利润	5,638.48	7,409.83	6,419.83	3,822.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,733.24	5,401.54	5,272.36	1,895.09
经营活动产生的现金流量净额	2,577.26	4,862.43	6,904.38	8,592.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,999
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,941
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京有研芯斯半导体科技有限公司	0	384,750,000	30.84	384,750,000	无	0	境内非国有法人
株式会社RS Technologies	0	327,090,400	26.22	327,090,400	无	0	境外法人
中国有研科技集团有限公司	0	230,422,500	18.47	0	无	0	国有法人
福建仓芯投资有限公司	0	28,215,000	2.26	28,215,000	无	0	境内非国有法人
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	-5,019,908	14,319,986	1.15	0	无	0	其他
国新风险投资管理(深圳)有限公司-深圳诺河投资合伙企业(有限合伙)	-8,221,311	14,278,689	1.14	0	无	0	其他
中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)	-118,917	8,881,083	0.71	0	无	0	其他
中信证券投资有限公司	-9,946,101	8,841,889	0.71	0	无	0	境内非国有法人
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	-4,474,251	8,559,953	0.69	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	6,757,690	8,064,251	0.65	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.北京有研芯斯半导体科技有限公司、株式会社RS Technologies实际控制人为方永义。 2.RS Technologies与仓元投资已签署一致行动协议。 3、中信证券之全资子公司中证投资持有公司157%的股份,持有研投基金2.74%的出资份额。 4.除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

存托凭证持有人情况

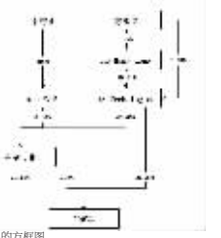
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2024年实现营业收入99,594.59万元,同比增加3.70%,公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润23,290.38万元,同比下降8.37%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润16,302.23万元,同比下降1.20%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688432　证券简称:有研硅　公告编号:2025-009

有研半导体硅材料股份公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2025年3月27日以通讯的方式召开。本次会议通知和资料于2025年3月17日通过电子邮件形式送达全体监事,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席王慧主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定,公司董事会编制了2024年度报告及其摘要。年度报告的内容与格式符合相关规定,客观、真实、公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项。公司2024年年度报告及摘要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《有研半导体硅材料股份公司2024年年度报告及其摘要》的内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司2024年年度报告》及《有研半导体硅材料股份公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(六)审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》

监事会认为:公司2024年预计与关联方之间的关联交易符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定。公司与关联方的关联交易均由日常生产经营活动需要所产生,系遵循公平及自愿原则进行,价格公允,交易公平,不存在损害公司和其他股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

子议案6.1 与RST了及其同一控制下的交易

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

关联监事田中利朗回避表决。

子议案6.2与中国有研及其同一控制下的交易

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

关联监事王慧回避表决。

子议案6.3 与关联方山东有研艾斯的交易

表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

关联监事王慧回避表决。

子议案6.4 与关联方山东尚泰的交易

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

子议案6.5 与关联方IVT株式会社的交易

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于2025年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2025-011)。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(七)审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2024年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在募集资金存放、使用与管理的违规情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-013)。

表决结果:3票同意,0票反对,0弃权。

(九)审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事李磊回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为:公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到有效地贯彻执行,内部控制健全、合理、有效,能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。公司《2024年度内部控制评价报告》符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规要求。报告内容真实、准确,客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况,公司不存在内部控制重大或重要缺陷。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《有研半导体硅材料股份公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会

2025年3月31日

证券代码:688432　证券简称:有研硅　公告编号:2025-010

有研半导体硅材料股份公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每10股派发现金红利人民币0.6元(含税),不送红股,不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●实施权益分派的股权登记日前有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币230,695,166.89元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。截至2024年12月31日,公司总股本1,247,621,058股,扣除回购股份3,555,336股,以此计算本次拟派发现金红利74,643,943.32元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.05%。本年度以现金为对价,采用集中竞价方式已实施的股份回购金额35,931,966.48元(不含印花税、交易佣金等交易费用),现金分红和回购金额合计110,575,909.80元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例47.48%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计74,643,943.32元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例32.05%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积转增股本。

如在本次分配预案公告至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定,不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下表:

单位:人民币元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	74,643,943.32	87,297,920.70	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	232,903,753.41	254,181,046.52	351,325,404.71
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)			230,695,166.89
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			161,941,864.02
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			0
最近三个会计年度平均净利润(元)			279,470,068.21
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			161,941,864.02
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于3000万元			否
现金分红比例(%)			57.95
现金分红比例(E)是否低于30%			否
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)			245,207,247.25
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在2亿元以上			否
最近三个会计年度累计营业收入(元)			3,131,668,434.67
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)			7.83
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(H)是否在15%以上			否
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

(二)监事会意见

公司于2025年3月27日召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为,公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形,同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不会造成公司流动资金短缺,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会对公司正常经营发展产生不利影响。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年3月31日

证券代码:688432　证券简称:有研硅　公告编号:2025-011

有研半导体硅材料股份公司关于2025年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本事项尚需提交公司股东会审议。

●关联交易对上市公司的影响:公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依照市场价格定价、交易;上述关联交易均是公司的正常业务,有利于公司经营业务的开展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

有研半导体硅材料股份公司(以下简称“公司”、“有研硅”)于2025年3月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》,关联董事方永义、张果虎、薛玉樑、远藤智、矶贝和范回避了相关事项的表决,相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

本事项尚需提交公司股东会审议通过,关联股东将在股东会上回避表决。

公司于2025年3月27日召开了独立董事专门会议2025年第二次会议,独立董事进行审议并发表意见:公司与株式会社RS Technologies及其同一控制企业、中国有研科技集团有限公司及其同一控制企业、山东有研艾斯半导体材料有限公司、山东尚泰新材料有限公司、INTER-VALVE TECHNOLOGY CO.等主体发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格、价格公允,不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此,我们对公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易予以认可,并同意将该议案提交公司董事会、公司股东会审议。

(二)本次关联交易预计金额和类别

相关交易主体的简称如下:

株式会社RS Technologies的简称为RST,中国有研科技集团有限公司的简称为中国有研,山东有研艾斯半导体材料有限公司的简称为山东有研艾斯,山东尚泰新材料有限公司的简称为山东尚泰,INTER-VALVE TECHNOLOGY CO.的简称为IVT株式会社。

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额(2025年4月1日-2026年3月31日)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(未经审计)	上年实际发生金额(2024年4月1日-2025年3月31日)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及设备	RST及同一控制	700.00	0.91	-	324.82	0.37	
	山东有研艾斯	9,000.00	11.70	387.88	1,297.63	1.47	产品认证随续通过,采购增加
	山东尚泰	3,000.00	3.90	4.04	26.23	0.03	预计采购需求增加
	IVT株式会社	100.00	0.13	0.66	2.22	0.00	
	小计	12,800.00	16.64	392.58	1,650.90	1.87	
接受关联人提供的劳务	RST及同一控制	500.00	8.33	-	-	-	预计接受关联方提供劳务
	山东有研艾斯	30.00	0.50	5.03	20.14	0.34	
	中国有研及同一控制	500.00	8.33	47.89	222.86	3.71	接受关联方提供测试服务需求增加
	小计	1,030.00	17.16	52.92	243.00	4.05	
向关联人销售商品	RST及同一控制	10,760.00	11.54	1,511.70	7,062.54	7.57	根据实际方需求增加
	中国有研及同一控制	1,000.00	1.07	93.83	95.96	0.10	根据实际方需求增加
	山东尚泰	2,000.00	2.14	-	-	-	根据关联方需求增加
	小计	13,760.00	14.75	1,605.53	7,158.50	7.67	
向关联人提供劳务	山东有研艾斯	2,000.00	95.15	265.23	1,790.09	93.68	
	小计	2,000.00	95.15	265.23	1,790.09	93.68	
向关联方出租	山东有研艾斯	150.00	100.00	10.66	153.79	100.00	
	小计	150.00	100.00	10.66	153.79	100.00	
从关联方承租	山东有研艾斯	10.00	1.83	1.65	6.62	1.27	
	中国有研及同一控制	500.00	91.43	99.47	391.63	75.20	
	小计	510.00	93.26	101.12	398.25	75.20	
为关联方代收代付	山东有研艾斯	1,500.00		222.95	1,374.37		
	小计	1,500.00		222.95	1,374.37		
接受关联方代收代付	山东有研艾斯	30.00		0.75	4.33		
	中国有研及同一控制	30.00		0.57	7.44		
	小计	60.00		1.32	11.77		
合计		31,810.00		2,652.31	12,780.67		

注1:上述日常关联交易在总额范围内,公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂);

注2:上方分项与小计/合计数之间差异系四舍五入尾差所致;

注3:2025年1-3月关联交易累计发生金额未经审计。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额(2024年4月-2025年3月)	上年(前次)实际发生关联交易金额(2024年4月-2025年3月)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及设备	RST及同一控制	400.00	324.82	
	山东有研艾斯	5,000.00	1,297.63	产品认证速度比预期略缓
	山东尚泰	5,000.00	26.23	公司调整采购需求
	IVT株式会社	-	2.22	
	小计	10,400.00	1,650.90	
接受关联人提供的劳务	山东有研艾斯	30.00	20.14	
	中国有研及同一控制	100.00	222.86	
	小计	130.00	243.00	
向关联人销售产品、商品	RST及同一控制	7,350.00	7,062.54	
	中国有研及同一控制	-	95.96	
	山东尚泰	5,000.00	-	关联方采购需求变化
	小计	12,350.00	7,158.50	
向关联人提供劳务	中国有研及同一控制	2.00	-	
	山东有研艾斯	2,100.00	1,790.09	
	小计	2,102.00	1,790.09	
向关联方出租	山东有研艾斯	210.00	153.79	
	小计	210.00	153.79	
从关联方承租	山东有研艾斯	7.00	6.62	
	中国有研及同一控制	500.00	391.63	
	小计	507.00	398.25	
为关联方代收代付	山东有研艾斯	1,700.00	1,374.37	
	小计	1,700.00	1,374.37	
接受关联方代收代付	山东有研艾斯	30.00	4.33	
	中国有研及同一控制	30.00	7.44	
	小计	60.00	11.77	
合计		27,459.00	12,780.67	

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

株式会社RS Technologies为日本上市公司,是有研硅的控股股东,成立于2010年12月10日,注册资本5,701.73百万日元,法定代表人、实际控制人方永义,总部位于东京都品川区大井一丁目47番1号,工厂位于宫城县大崎市三本木音无字山崎26-2。其经营范围主要包括电子机器、电子材料、电子设备零件、通信设备零件材料的设计、加工、再利用,销售和进出口;半导体硅片制造、加工、进出口和销售,技术咨询等。按照2024年12月31日人民币兑换日元的汇率100日元=4.6233人民币换算折合,2024年度公司总资产842,119.43万元,净资产626,679.27万元,营业收入273,703.97万元,净利润43,675.69万元。公司董事长方永义担任其董事长。

中国有研科技集团有限公司(曾用名:有研科技集团有限公司)成立于1993年3月20日,注册资本300,000万人民币,有限责任公司(国有独资),法定代表人赵晓晨,注册地址:北京市西城区新外大街2号。其经营范围为金属、稀有、稀土、贵金属材料及合金产品、五金、交电、化工和精细化工原料及产品(不含危险化学品)、电池及储能材料、电讯器材、机械电子产品、环保设备、自动化设备的生产、研制、销售;信息网络工程的开发;技术转让、技术咨询、技术服务;承接金属及制品分析测试;自有房屋和设备的租赁;进出口业务;项目投资;投资管理;广告发布。中国有研科技集团有限公司为非公众公司,无法对外提供财务数据。中国有研科技集团有限公司是持有公司5%以上股份的主要股东。

山东有研艾斯半导体材料有限公司成立于2020年3月11日,法定代表人同志瑞,主要股东为德州汇达半导体股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中国有研、有研硅。其经营范围主要为半导体材料及其他新材料的研发、生产、销售;半导体材料及其他新